

DA 90-50 晶片黏接膠 产品数据表

高導熱性

優異的防潮性能

高可靠性

简介

DA 90-50 是一種銀填充、高導熱、無溶劑、快速固化的熱固性晶片黏接劑。DA 90-50 對基材和裸晶片均具有優異的黏接性能，適用於小型和大型晶片的黏合。它可以透過點膠或印刷的方式進行塗覆。本產品已展現出高可靠性和高溫回流焊接性能。

物理特性

产品名称	DA 90-50 晶片黏接膠
外觀	白色
填充物	銀
未固化材料性能	
项目	数值
比重(ASTM D1475-60)	3.0 g/cc
黏度(@35°C)	45-60 k cp
已固化材料性能	
拉伸強度(MPa)	56
C.T.E (ASTM E831) PPM/°C	35
楊氏模量 (GPa)	2-3.5
導熱係數 (w/m.k)	2-5
體積電阻率 (Ω.cm)	10 ⁻⁴

模具剪切強度 (Kg/mm2)	2x2mm 矽晶片(鈹基底):2.0 2x2mm 鍍金矽晶片(裸銅基底):2.5 2x2mm 鍍金矽晶片(金基底):2.3
提取离子(MIL-STD-883E)	
Na ⁺	< 5 ppm
K ⁺	<5 ppm
F ⁻	< 5 ppm
Cl ⁻	< 10 ppm

推荐干燥/固化工艺

在 170-190°C 的溫度下固化 30-50 分鐘。注意：固化時間不包括預熱時間。

储存与保质期

在 -40 °C 以下条件下, 如材料保持于密封的原始容器中, 保质期为 6 个月。超过该存储期限, 材料粘度可能会升高。请避免材料受到水分、挥发损失及异物污染, 否则可能对产品的加工性能产生不利影响。

安全信息

DA 90-50 为环保型、无毒材料。但在操作和使用过程中, 仍建议遵循基本的工业卫生规范。有关更详细的安全信息, 请参阅本产品的 材料安全数据表。

包装规格

DA 90-50導電膠提供10毫升和30毫升兩種包裝規格。其他包裝規格可依客戶需求提供。如需訂購信息, 請聯繫YINCAE公司。